

# 微細ディスペンス用ペースト

## Solder Paste for Fine Dispensing

- 高融点 Sn-10Sb : 245-266 °C
- 標準 Sn-3.0Ag-0.5Cu : 217-220 °C
- 低融点 Sn-58Bi : 139 °C

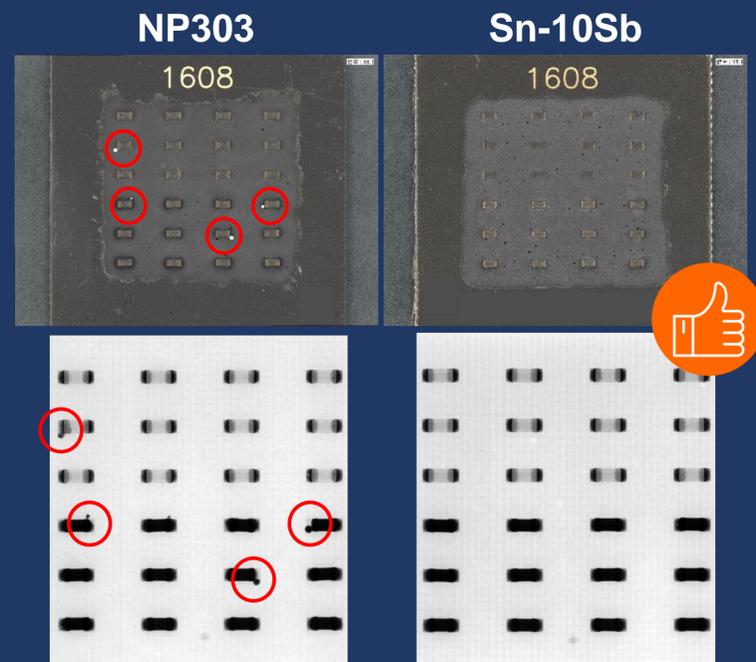
- Type 5, 6, 7

- 無洗浄
- 水溶性

- Jet Dispense
- Air Dispense

### 高融点シリーズ

2回目加熱での再溶融防止！  
テスト温度：245°C

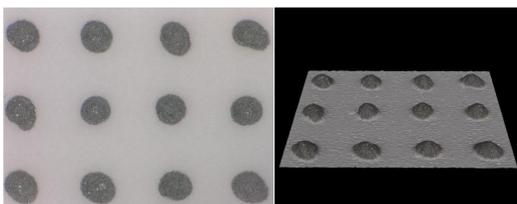


高融点はんだを使用するため、再溶融しにくい

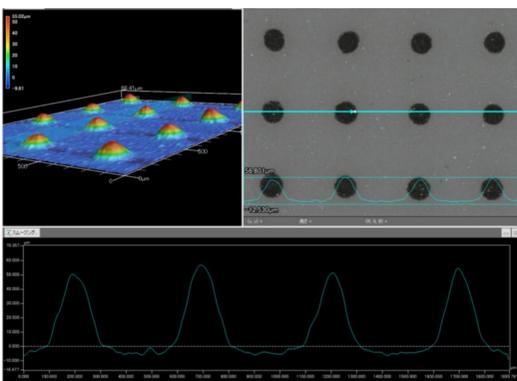
### Jet Dispense シリーズ

Jet Dispense向けの **winDot** ペースト  
Φ200 μm以下の吐出可能！

吐出形状



3D分析

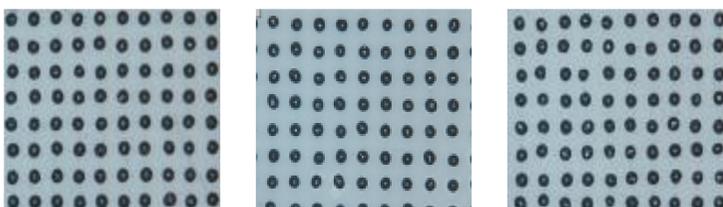


連続安定吐出

初期

30万点

50万点



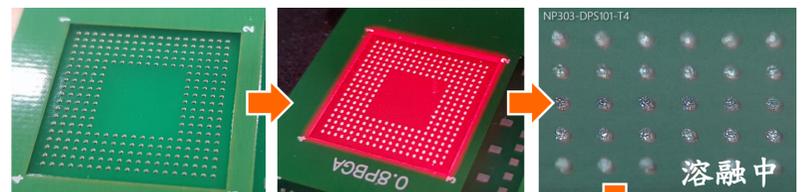
winDot-F005-NP303

### Air Dispense シリーズ

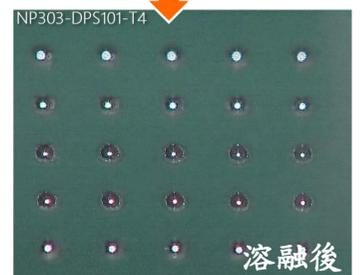
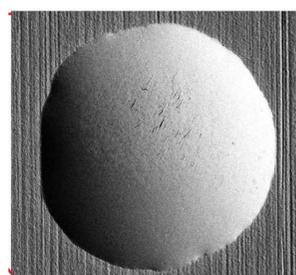
同時に溶融開始、均一な溶融挙動

Area Laser Soldering

NP303-DPS101-T4

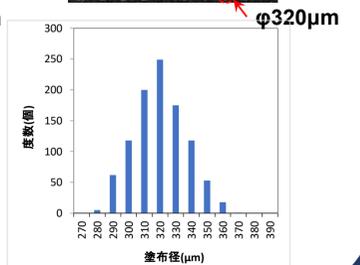
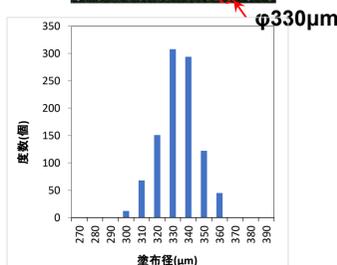
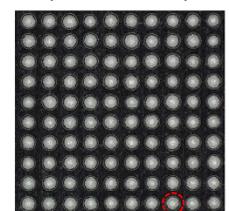
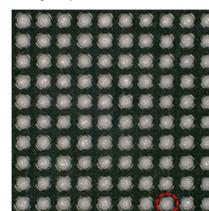


洗浄性良好



1点-10万点

36万点-37万点



連続安定吐出